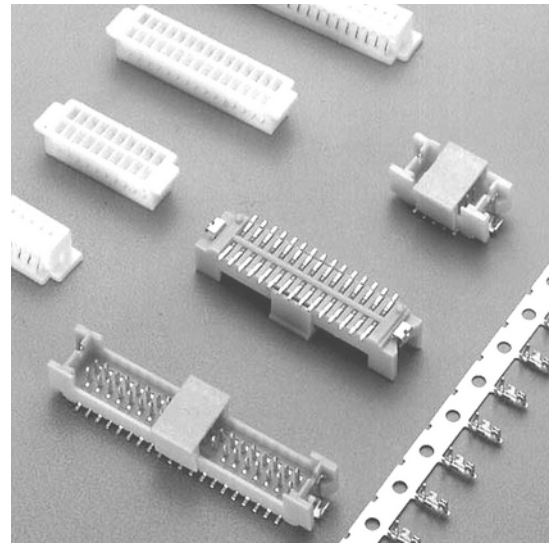


SMT-Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 1,25mm, stehend, 2-reihig SMT Friction Lock Headers / Crimp Housings, 1.25mm Pitch, Vertical, Double Row

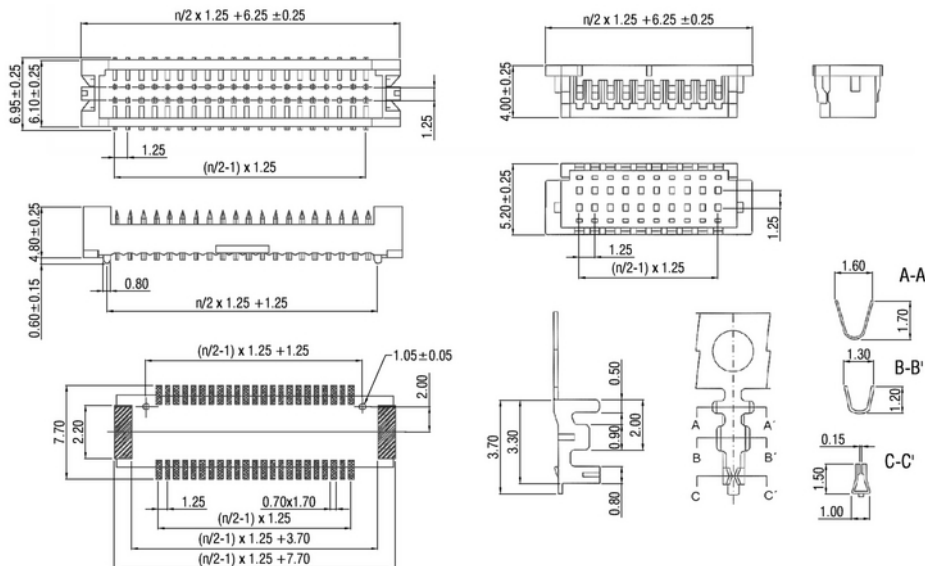
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 28 ... 32
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 500MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V _{AC}
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100V _{AC}
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25°C ... +85°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

In weiß und beige erhältlich.
Available in white and beige.



Series	Contacts*	Type	Plating*	Packing*
1250	20 10/20/30/40	10 10 Wannenstecker Box header	00 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated	ST ST In Stangen In tubes TR Tape & Reel Tape & Reel

Series	Contacts*	Type	Packing
1250	20 10/20/30/40	20 20 Crimp-Gehäuse Crimp Housing	00

Series	Contacts	Type	Plating*
1250	01	30 30 Crimp-Kontakte AWG28-32 Crimp terminals AWG28-32	50 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wpro.com
WEBSITE www.wpro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

